



新聞稿 敬請惠予刊登
2008年10月15日共2頁

飛索半導體 Spansion 與日月光簽署後段製造合資備忘錄 合資經營飛索位於蘇州之封測廠

全球最大的專業快閃記憶體解決方案供應商飛索半導體 (Spansion Inc.，以下簡稱“飛索”)(NASDAQ: SPSN)與全球第一大半導體封裝測試廠日月光半導體(以下簡稱“日月光”)(TAIEX: 2311, NYSE: ASX)，今日宣佈雙方已簽署備忘錄，將成立合資公司以共同擁有飛索位於中國蘇州之後段生產製造廠。此項備忘錄的細項內容尚未揭露。

今日的宣佈對飛索的策略而言是一個重大的里程碑，飛索能夠專注在自己的核心競爭力上並與半導體後段製造之領導廠商建立策略聯盟。透過與日月光合資的安排，飛索未來將得以降低資本支出，而由於經濟規模之提升，資產的使用率也將提高。透過夥伴關係的建立，飛索能將資源集中於具有市場穩固領導地位之無線和嵌入式產品的開發；並將以創新、新一代的快閃記憶體解決方案提供更多樣化的產品，並且加速促進尖端快閃記憶體產品的技術藍圖。

飛索總裁及執行長Bertrand Cambou表示：「日月光是全球半導體後段製造服務的領先廠商，透過與日月光的合作，未來蘇州廠將爭取更多客戶，期望藉由提高經濟規模和增加設備的使用率，以降低成本。」

透過本合資案，日月光現有的產品、生產製造以及發展的策略將更加完整，將可以提供客戶更廣泛的封裝和測試服務。未來蘇州廠將持續提供飛索後段的製造服務，同時也期盼能藉由日月光在半導體後段製造的先進技術及專業管理能力來服務更多客戶。

日月光集團董事長張虔生表示：「飛索是快閃記憶體的領導廠商，並以先進記憶體技術以及先進封裝技術贏得業界之高度肯定。透過本合資案日月光將得以在高速成長之快閃記憶體市場占有關鍵的地位，我們也很期待未來更多半導體廠商因資產輕量化之策略而提高外包的需求，日月光也全力準備迎接如此有利的產業趨勢與機會。」

飛索蘇州廠是飛索半導體在後段封測生產據點的旗艦廠，目前約有1,100名員工，自1998年開始在中國營運，至今通過了ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002, ISO 14001以及OHSAS 18001等認證。飛索蘇州廠主要生產項目：MCP(Multi Chip Package)的研發及量產、FBGA以及TSOP的封裝、測試、蓋印、包裝以及客戶服務等。

本合資案之最終條款仍俟雙方協商後確定，並將簽署包括為期數年之服務合約等各項合資約定。視取得相關主管機關核准之進度，飛索和日月光計劃於2008年第四季簽署最終之合資契約並完成此項交易。

關於飛索半導體 Spansion Inc.

飛索半導體Spansion Inc. (NASDAQ: SPSN) 是領先的快閃記憶體解決方案供應商，致力於無線、汽車、網路和消費電子應用提供數位內容的支援、存儲和保護。Spansion的前身是一家由AMD和富士通合資的公司。它是全球最大專門致力於設計、開發、生產、行銷和銷售快閃記憶體解決方案的公司。如需瞭解更多資訊，請查詢www.spansion.com網站。

關於日月光集團 (Advanced Semiconductor Engineering Group)

日月光集團為全球第一大半導體製造服務廠。身為全球領導廠商，我們不斷提供更快速、更小型化與高效能的晶片，以符合半導體產業需求成長。集團也持續發展和提供客戶廣泛完整的技術及解決方案，包括晶片測試程式開發、前段工程測試、晶圓針測、晶圓凸塊、基板設計與製造、晶圓級封裝、覆晶封裝、系統級晶片封裝至成品測試之服務以及透過集團中的子公司環隆電氣，獲得完善的電子製造服務整體解決方案。日月光集團2007年之營收達31億美元，全球員工人數超過2萬8千人。欲查詢詳細資訊，請至www.aseglobal.com 網站。

#

警告性聲明

本新聞稿含有的前瞻性聲明符合《1995年美國私人證券訴訟法改革法案》安全港條款規定之前瞻性聲明，包括有關下列各項的聲明：任何技術對具體應用或產品的適用性；開發和部署 43nm 制程 ORNAND2、EcoRAM、MirrorBit NOR 和 Eclipse 技術的計畫；提供更具成本優勢的產品或解決方案的任何計畫；開發未來技術的任何計畫以及公司在開發此類技術方面可能具有的領先優勢；提高產品性能和品質的能力；或者利用戰略關係實現潛在收益的能力。在此提醒投資者，本新聞稿中的前瞻性聲明具有風險及不確定性，可能導致實際結果與本公司當前期望實質性不同。對於此類風險及不確定性，公司敦請投資者詳細審閱公司向美國證券交易委員會呈交的檔，包括但不限於公司截至 2007 年 12 月 30 日的財政年度出具的 Form 10-K 年度報告和截至 2008 年 6 月 29 日的 Form 10-Q 季度報告。公司無義務更新本新聞稿中的前瞻性聲明或資訊。

Spansion®、Spansion 標誌、MirrorBit®、MirrorBit® Eclipse™、ORNAND™、ORNAND2™、HD-SIM™、Spansion® EcoRAM™及其組合均為 Spansion LLC 在美國和其他國家註冊的商標。其他名稱僅供資訊識別之用，可能是它們各自所屬企業的商標。

SOURCE Spansion Inc.

媒體聯絡人：

日月光集團

劉詩亮 副總經理

電話：(02)8780-5489